

기술분석보고서 산업재

다산솔루에타(154040)



작성기관 NICE평가정보(주) 작성자 이서원 연구원

[▶ YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)로 연락하여 주시기 바랍니다.

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

다산솔루에타(154040)

스마트 디바이스용 전자파 차폐·방열 소재 전문기업

기업정보(2025.11.27 기준)

대표자	안상헌
설립일자	2003.06.27
상장일자	2013.12.27
기업규모	중소기업
업종분류	산업재
주요제품	전자부품(전자파 차폐소재) 제조

시세정보(2025.11.27 기준)

현재가(원)	1,094
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	196
발행주식수	17,950,094
52주 최고가(원)	1,499
52주 최저가(원)	918
외국인지분율(%)	1.63
주요주주	(주)다산인베스트, (주)퍼시픽블루, (주)다산네트웍스, 남민우

■ 전자파 차단소재 제조기업

(주)다산솔루에타(이하 동사)는 2001년 전신인 에스테크 설립을 시작으로 2003년 법인 전환 후 전자제품용 전자파 차단(EMI/EMC) 소재 제조 및 판매 사업을 주력으로 성장해 온 기업이다. 동사는 전도성테이프, 전도성쿠션 등 전자파 차폐용 기능성 소재를 중심으로 스마트폰, 노트북, TV 등 다양한 전자기기에 적용되는 차폐부품을 공급하고 있으며, 글로벌 IT 제조사의 고사양 제품 개발 요구에 신속히 대응하고 있다.

■ 전자파 차단·흡수 및 고방열 전자소재 분야의 핵심 기술 보유

동사는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 등 고집적 전자기기에 적용되는 전도성테이프·전도성쿠션·EMI 차폐시트를 중심으로 전자파 간섭(EMI/EMC)을 억제하는 핵심 전자소재 기술을 보유하고 있다. 니켈·구리 도금 및 기능성 코팅 기술을 기반으로 차폐율·점착력·두께 등 고객사별 요구 사양을 정밀하게 구현할 수 있으며, 도금-점착-가공이 통합된 수직계열화 생산체계를 통해 품질 안정성과 대량 양산 대응력을 확보하고 있다. 또한 그 래핀·고방열 필름·전파흡수체 등 차세대 기능성 소재 기술도 개발하며, 고주파·초박형화가 가속되는 글로벌 IT 디바이스 시장에서 요구되는 고성능 전자소재 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

■ 글로벌 IT 공급망 확대와 소재기술 고도화에 따른 성장 기대

스마트디바이스의 고주파·고집적화가 가속되면서 EMI/EMC 차폐소재와 고방열 기능성 소재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 글로벌 제조사들의 공급망 다변화 기조 역시 전문 소재 기업에 새로운 진입 기회를 제공하고 있으며, 동사는 일체형 생산공정과 고신뢰성 소재 생산능력을 기반으로 이러한 시장 확대의 수혜를 받을 것으로 예상된다. 또한 최근 추진하고 있는 사업 구조 재편과 해외 고객사 확대 전략은 수출 비중 증가와 제품 포트폴리오 고도화로 이어질 가능성이 높아, 중장기적으로 안정적 매출 기반 확보와 소재 중심 기업으로의 경쟁력 강화가 기대된다.

요약 투자지표 (2022/2023년 K-IFRS 연결, 2024년 K-IFRS 개별 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2022	1,579	17.3	57	3.6	40	2.5	10.77	2.57	277.2	290	2,011	8.42	1.21
2023	1,588	0.6	-1	-0.1	265	16.7	55.28	15.88	160.2	1,491	3,322	1.25	0.56
2024	354	-77.7	20	5.6	-193	-54.5	-39.15	-14.52	113.9	-1,076	2,176	N/A	0.52

기업경쟁력

전자파 차폐·방열 소재 분야 핵심 기술력 보유

- 전도성테이프·전도성쿠션·EMI 차폐시트 등 스마트디바이스용 전자파 차단소재 핵심 기술 확보
- 니켈·구리 도금, 기능성 코팅, 고방열 필름 등 다양한 기능성 소재 기술 보유
- 초박형·고주파 환경 대응이 가능한 전자소재 개발로 글로벌 IT 제조사 품질 기준 충족
- 도금 → 점착제 코팅 → 가공까지 단일 라인에서 수행하는 일체형 생산공정 보유
- 고객사별 규격(두께·점착력·전도율)에 맞춘 맞춤형 소재 생산 가능
- 안정적인 대량 양산능력과 납기 대응력으로 글로벌 공급망에서 신뢰성 확보

도금-점착-가공 수직계열화 생산체계

핵심 기술 및 적용 제품

EMI 차폐·흡수 소재 기술

- 고집적 전자기기 내부 전자파 간섭(EMI)을 억제하기 위한 전도성테이프, 전도성쿠션, EMI 차폐시트 제조 기술 보유
- 니켈·구리 도금 및 기능성 코팅을 적용하여 차폐율·점착력·두께 등 다양한 고객사 규격에 대응

고방열·신기능성 필름 및 소재 기술

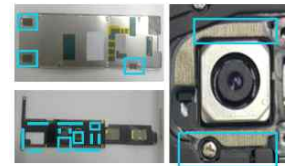
- 그래핀 기반 고방열 소재 및 기능성 필름 제조 기술 보유
- 고성능 AP·배터리 등 열 발생 부품의 발열을 빠르게 확산시키는 방열 시트 및 탄소계 필름 개발

동사의 주요 제품

Conductive Fabric Tape



Conductive Cushion Tape



시장 경쟁력

글로벌 IT 제조사 대응 가능한 고신뢰성 소재 공급 능력

- 전도성테이프·전도성쿠션·EMI 차폐시트 등 스마트디바이스용 핵심 소재를 장기간 공급하며 글로벌 제조사의 품질 요구 충족
- 스마트폰·노트북·웨어러블 등 제품군 전반에 적용 가능한 초박형·고성능 소재 기술을 기반으로 해외 고객사 확대에 유리한 경쟁환경 확보

차세대 전자소재 수요 확대에 부합하는 기술·공정 경쟁력 확보

- 그래핀 기반 기능성 필름, 고방열 시트 등 차세대 전자소재 기술을 지속 개발
- 이러한 기술 고도화는 글로벌 공급망 다변화 흐름과 맞물려 신규 적용처 확대 기회 제공

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E

환경경영

- ◎ 전자파·열 저감 중심의 친환경 소재 솔루션을 제공하여 에너지 효율 향상, 불필요한 전력 소모 저감, 전자파 영향 최소화에 기여
- ◎ 도금-코팅-점착을 포함하는 One-stop 생산체계를 보유하여 자원·설비 활용 효율을 높이고 있으며, 동일 공정 내 다양한 소재를 생산함으로써 에너지·원자재 사용량을 절감

S

사회책임경영

- ◎ 당사는 윤리경영 원칙을 통해 고객·주주·임직원·협력사·지역사회와의 동반 성장을 강조하고, 공정한 거래와 사회적 책임 준수를 핵심 가치로 삼고 있음
- ◎ 부당·불공정·비합리적 관행을 기업 경영의 해악으로 규정하고 이를 배제하는 윤리경영 현장 운영 중

G

기업지배구조

- ◎ 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인으로 구성
- ◎ 이사회 및 주주총회를 정기적으로 운영하며 투명한 경영체계 구축
- ◎ 재무 및 의사결정 정보를 투명하게 공개하여 주주가치 제고

I. 기업 현황

전자파 차단 소재 전문기업

동사는 2003년 전자파 차단 소재 제조를 목적으로 설립되어 도금·점착·가공의 일원화된 생산체제를 기반으로 전도성테이프와 전도성쿠션을 공급하고 있다. 코스닥 상장 이후 생산설비 확충과 신소재 개발을 통해 스마트기기 및 전장 시장에서 안정적인 매출 기반을 확보하고 있다.

■ 기업 개요

동사는 2003년 전기·전자·통신제품용 전자파 차단 소재의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2013년 12월 코스닥 시장에 상장하였다. 설립 초기에는 전자파 차폐 소재를 구매하여 가공·납품하는 형태로 휴대폰, 노트북 등 IT기기 시장에서 사업을 영위하였으나, 2008년 도금 설비 구축과 2012년 점착 공정 확보를 통해 원재료부터 완제품까지 생산 가능한 수직계열화를 완성하며 EMC(전자파 적합성) 소재 전문기업으로 도약하였다. 주요 사업은 스마트폰·태블릿·노트북 등 Smart Device 및 전장·IoT 기기 등에 적용되는 전도성테이프, 전도성쿠션 등 전자파차단소재(EMI/EMC 소재) 제조·판매 사업으로 단일 사업부문으로 구성된다. 동사는 국내 자체 생산시설을 기반으로 글로벌 전자기기 제조사의 품질·납기 요구에 대응하고 있으며, Apple·삼성전자·LG전자 등 최종 수요자의 신제품 개발 과정에서 Spec-in 요구에 대응할 수 있는 기술력과 생산능력을 주요 경쟁력으로 보유하고 있다. 한편, 종속회사였던 (주)디엠씨는 2024년 지분 매각으로 연결대상에서 제외되었고, 마스크용 MB필터 사업 또한 2023년 영업 중단을 결정하는 등 비핵심 사업을 정리하여 전자파 차단 소재 중심의 사업구조를 강화하였다.

■ 주요 연혁 및 대표이사 주요 이력

동사는 2003년 설립 이후, IT 기기 경량화 및 고성능화 시대의 확산에 맞추어 EMC(전자파 적합성) 소재 기술을 고도화해 왔다. 설립 초기에는 전도성 원단을 구매해 가공·납품하는 단순 가공 중심의 구조였으나, 2008년 자체 도금 라인을 구축하여 소재 생산 역량을 확보하였고, 2012년 점착 공정을 추가함으로써 업계 최초로 원재료-도금-점착-가공을 아우르는 수직계열화 체제를 완성하였다. 2013년에는 코스닥 시장에 상장하며 외형 성장을 위한 기반을 마련하였고, 2018년에는 마도 신공장으로 이전해 생산 설비·클린룸을 확충함으로써 글로벌 스마트기기 제조사의 Spec-in 요구에 대응할 수 있는 양산 경쟁력을 확보하였다. 이후 전자파 차단 소재 분야의 기술 포트폴리오 확대를 위해 그래핀·고방열 박막·니켈 나노파우더 등 신소재 관련 특허를 지속적으로 출원·등록하며 제품군을 고도화하였다. 현재 동사는 전도성테이프·전도성쿠션 등 핵심 EMI 소재를 기반으로 글로벌 스마트기기·전장·IoT 시장의 고주파·고집적화 흐름에 대응하며 지속적인 사업 확장을 도모하고 있다.

그림 1. 주요 연혁



출처: 동사 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

다산솔루에타(154040)

대표이사 안상현은 서울대학교 무기재료공학과를 졸업한 이후, 토다이수 연구소, 신사업부문, 이수세라믹 생산기술팀 부장 등을 역임하며 기술·운영 전반에 대한 전문성을 쌓아왔다. 이러한 제조기술 및 신사업 관련 경험을 바탕으로 2024년 대표이사로 취임한 뒤 현재까지 동사의 경영 전반을 총괄하고 있으며, 조직 안정화와 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있다.

■ 종속회사 및 주주 현황

동사는 2024년 중 종속회사 구조 변동이 발생하였다. 기존 종속법인이었던 SOLUETA VINA CO., LTD는 2023년 매각을 완료하면서 연결 범위에서 제외되었고, 2024년에는 자동차부품 사업을 영위하던 (주)디엠씨의 지분이 67.0%에서 15.4%로 감소함에 따라 연결 종속회사 요건을 충족하지 못하게 되어 종속회사에서 제외되었다. 2024년 10월에는 (주)디엠씨 잔여 지분도 전량 매각하였다. 이에 따라 당기에는 연결대상 종속회사가 존재하지 않으며, 사업구조는 전자과 차단 소재 단일 사업부문 중심으로 재편되었다.

2025년 3분기 말 기준, 동사의 최대주주는 (주)다산인베스트로 2,627,302주(14.64%)를 보유하고 있으며, 2대 주주는 (주)퍼시픽블루로 1,878,000주(10.46%)를 보유하고 있다. 이외 주요특수관계자로는 창업자 남민우가 1,938,263주(10.80%)를 보유하며, 대표이사 안상현 역시 10,000주를 보유하고 있다. 상기 주요 주주 외 기타 주주의 보유분은 11,496,529주로 전체의 64.05%를 차지하고 있으며, 5% 이상 주주는 (주)다산인베스트, (주)퍼시픽블루, 남민우 3인으로 구성된다.

그림 2. 주주 현황



출처: 동사 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 사업분야 및 매출 현황

동사는 전자과 차단 소재(EMI/EMC 소재)를 중심으로 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 주요 제품은 전도성테이프와 전도성쿠션 등으로 구성된다. 전도성테이프는 전자기기 내부의 전자과 간섭을 차단하는 용도로 사용되며, 전도성쿠션은 차폐 기능과 충격 흡수 기능을 동시에 제공해 스마트기기·전장부품 등 다양한 제품의 내부 구조 안정성 확보에 활용된다. 2025년 3분기 누적 매출 기준, 전도성테이프는 9,361백만 원으로 전체 매출의 37.10%, 전도성쿠션은 13,566백만 원으로 53.77%를 차지하여 핵심 매출원을 형성하고 있다. 이외 기타 제품 및 임대수익 등은 2,304백만 원으로 9.13% 수준이다. 수출 비중은 20,011백만 원으로 전체 매출의 약 79.31%를 차지하고 있으며, Apple·삼성전자·LG전자 등 글로벌 전자기기 제조사의 생산 증가에 직접적으로 영향을 받는 구조를 보인다.

표 1. 사업 분야별 매출액

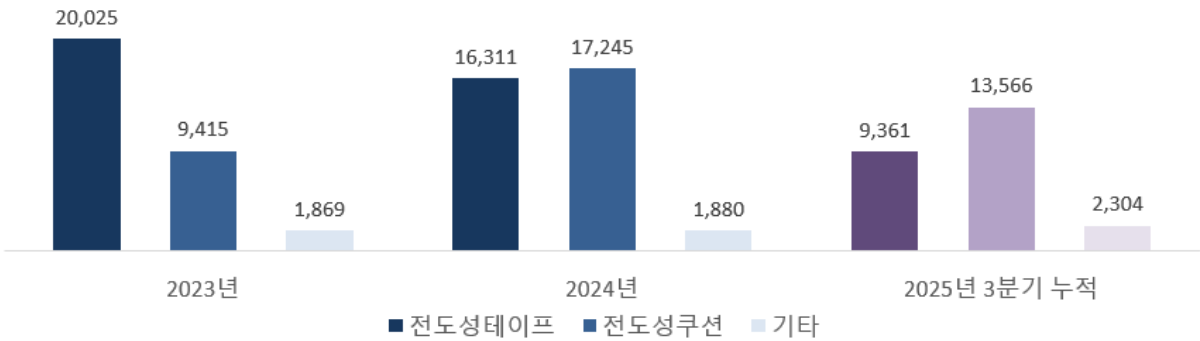
(단위: 천 원)

품목	매출유형	판매구분	2023년	2024년	2025년 3분기
전도성테이프	제품, 상품	내수	9,478,482	4,891,396	4,250,242
		수출	10,546,097	11,419,869	5,111,089
		소계	20,024,579	16,311,266	9,361,331
전도성쿠션	제품, 상품	내수	162,329	493,600	645,403
		수출	9,252,843	16,751,858	12,920,693
		소계	9,415,172	17,245,457	13,566,096
기타	제품, 상품, 임대수익	내수	1,254,909	338,935	324,551
		수출	614,170	1,540,752	1,979,175
		소계	1,869,079	1,879,686	2,303,726
내수 합계			10,895,719	5,723,931	5,220,195
수출 합계			20,413,111	29,712,479	20,010,958
합계			31,308,830	35,436,409	25,231,153

출처: 동사 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

그림 3. 사업 부문별 매출액 구조

(단위: 백만 원)



출처: 동사 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

II. 시장동향

스마트 디바이스 고도화로 EMI/EMC 소재 수요는 안정적 성장세 지속 전망

스마트폰·태블릿·노트북·웨어러블 등 스마트 디바이스의 고성능화와 고주파·다기능 무선통신 채택 확대에 따라 전자파 간섭 관리의 중요성이 높아지고 있다. 이에 따라 기기 내부 차폐·흡수용 소재의 수요는 단기 과열이 아닌 지속적·점진적 성장을 이어갈 것으로 전망되며, 폴더블·웨어러블·XR 기기 등 신규 디바이스 확산 또한 EMI/EMC 소재 시장의 안정적 확대를 견인할 것으로 예상된다.

■ 전자파 차폐 재료 산업의 특징과 동향

전자파 차폐 재료는 전자기기의 성능을 저하시키는 외부 전자기장(낙뢰, 정전기, 통신용 주파수 등)으로부터 기기를 보호하거나, 전자기기에서 발생된 전자기장이 외부로 방사되어 주변 전자기기의 오작동을 유발하지 않도록 차단하기 위해 사용되는 재료를 총칭한다. 전자파 차폐 재료 산업의 후방 산업은 기초 유기 및 무기계 재료, 가공장비 제조업 등이며, 전방 산업은 전자·통신기기 및 부품 제조업 등이다.

표 2. 전자파 차폐 재료 산업의 전후방 산업

후방 산업	기준 산업	전방 산업
		
금속, 고분자, 가공장비 등	전도성 페인트, 전도성 고분자, 금속판, 전자파 차폐 필터 및 테이프 등	컴퓨터, 디스플레이, 스마트폰, 통신장비, 자동차 등

출처: TDB기술시장보고서(2025), NICE평가정보(주) 재가공

전자파로 인해 발생할 수 있는 인체 유해성 논란, 전자파 간섭으로 인한 기기 오작동 문제, 통신 보안성 저하 등 다양한 위험 요인이 부각되면서 전자파 차폐 소재에 대한 산업적 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 관련 법규와 규제도 지속적으로 강화되고 있다. 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소는 인체가 전자파 장치나 고수준 전자파에 장기간 노출될 경우 발암 가능성이 존재한다고 분류하고 있으며, 전자파가 체온 상승, 세포 및 조직 기능 변화, 신경 및 근육 자극 등 다양한 생리적 변화를 유도할 수 있다는 점을 지적하고 있다. 국내에서도 전자파의 인체 영향과 안전 보호를 위한 제도 개선이 이어지고 있으며, 정부는 무선설비의 전자파 등급을 관리하고 전자제품이 적합성 기준을 충족하는지 평가하는 제도를 시행하고 있다.

과학기술정보통신부는 국가 전자파 종합대책을 수립하여 공공기관과 함께 전자파 측정망을 운영하고 있고, 생활환경에서 발생하는 전자파 수준을 감시하기 위한 로봇형 전자파 측정 시스템 등 기술적 대응도 확대하고 있다. 산업 현장에서는 생산성과 효율성 향상을 위해 자동화 시스템이 도입되면서 전자장비 밀집도가 증가해 전자파 간섭 문제가 더욱 커지고 있으며, 스마트 팩토리, 데이터 센터, 비상장치 등 고도화된 시설에서는 전자파로 인한 오작동 가능성이 높아짐에 따라 전자파 차폐소재의 중요성이 더욱 커지고 있다.

전자파 차폐 소재와 관련된 기술은 디스플레이, 무선 통신기기, 자동차·선박·항공기 등 운송수단, 우주·방

산 장비, 송전선·변전소, 스마트 건물, 에너지 저장 시스템, 조명 장비, 로봇 등 거의 모든 전기·전자장치 분야에서 폭넓게 활용되고 있다. 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 기기 등 모바일 디바이스는 GPS, Wi-Fi, Bluetooth 등 다양한 무선 통신 기능이 복합적으로 탑재되며 전자파 간섭에 더욱 민감해지고 있어 안정적인 성능 유지를 위해 차폐 소재의 필요성이 높아지고 있다. 또한 내부 부품 간 거리가 좁아지는 경향 속에서 회로·배터리·모듈 등 금속 부품의 밀집도가 상승하면서 전자파 차폐재의 성능은 기기의 품질과 내구성 확보에 직접적인 영향을 미치고 있다.

자동차 산업에서도 전장화·전동화 트렌드가 가속화되면서, 내비게이션·인포테인먼트 시스템·블루투스 모듈·레이더·카메라·배터리관리시스템(BMS) 등 다양한 전자부품이 차량에 탑재됨에 따라 차폐 소재의 필요성이 크게 증가하고 있다. 특히 자율주행차는 레이더·라이다 기반의 센서 시스템을 안정적으로 작동시키기 위해 전자파 간섭 억제에 필수적이어서 차폐 소재의 중요성이 더욱 강조되고 있으며, 고출력 배터리 및 전력 변환 장치의 전자파 발생도 증가해 성능과 안전성을 동시에 확보하기 위한 고신뢰성 차폐 기술이 요구되고 있다.

의료·보안 산업에서도 MRI, CT, X-ray, 심장 제세동기, 인공호흡기, 수술 로봇 등 다양한 장비의 안정성이 전자파 영향에 민감하므로, 의료기기의 정확한 작동과 환자 모니터링 시스템 신뢰성을 확보하기 위해 전자파 차폐 소재 솔루션이 필수적인 요소로 자리잡고 있다. 이처럼 다양한 산업에서 전자파 관리와 차폐 기술이 중요한 이슈로 부상하면서, 전자파 차폐 소재에 대한 투자가 확대되고 있으며 관련 시장 또한 빠르게 성장하고 있다.

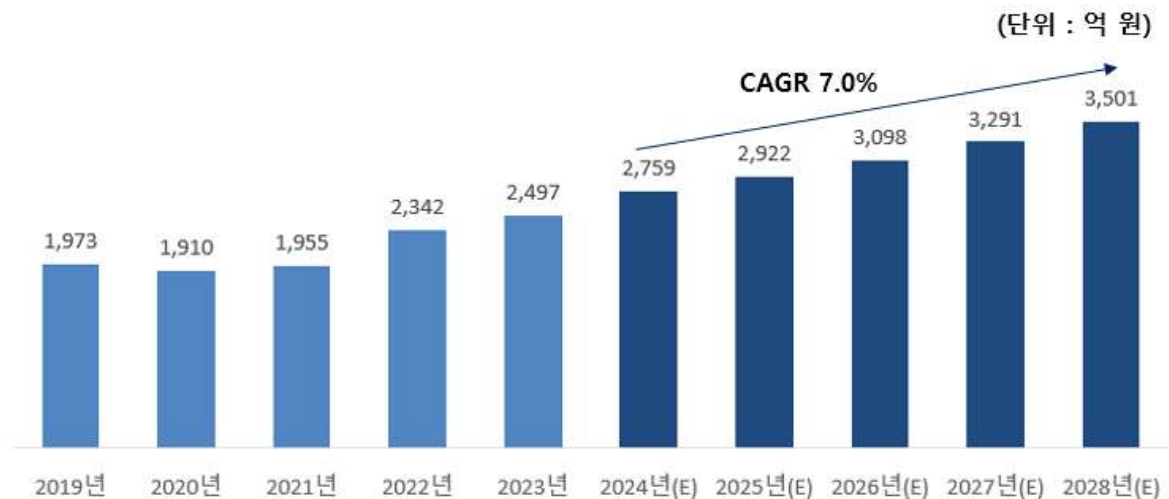
스마트폰과 태블릿, 노트북, 웨어러블 기기 등 스마트 디바이스의 고성능·초경량화 추세가 가속화되면서, 기기 내부에서 발생하는 전자파 간섭(EMI)에 대한 제어는 필수 요소로 자리잡고 있다. 5G·Wi-Fi 6/7·초고주파 대역 채택 등 무선 통신 성능이 고도화됨에 따라 회로 집적도가 높아지고 부품 간 간섭 가능성이 커지면서, 전도성테이프·전도성쿠션과 같은 EMI/EMC 소재 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 특히 스마트폰과 웨어러블 기기는 제한된 공간에서 배터리, 카메라 모듈, 안테나, AP 등이 고밀도로 배치되기 때문에 고차폐·저두께·고신뢰성의 복합 소재 요구가 확대되고 있는 것이 특징이다.

또한 Apple, 삼성전자, LG전자 등 글로벌 제조사는 신제품 개발 주기가 짧아지고 기능이 다양해지면서 소재 공급망 전반에서 안정적 품질과 즉각적 대응 능력을 요구하고 있으며, 이로 인해 소재 기업은 도금·점착·가공 등 생산 공정의 내재화와 기술 혁신을 강화하는 추세다. 더불어 웨어러블·AR/VR 기기, 무선충전 IoT 디바이스 등 신규 스마트 디바이스의 확산과 함께 전자파 적합성(EMC) 규제가 강화되고 있어, 고성능 EMI 차폐 소재의 중요성은 지속적으로 확대될 것으로 전망된다.

■ 전자파 차폐 재료 시장 규모 및 전망

국내 전자파 차폐 재료 시장규모는 2023년 기준 2,497억 원이며, 이후 연평균 7.0% 증가하여 2028년 3,501억 원에 이를 것으로 전망된다. 국내 전자파 차폐 재료 시장은 세계 수준의 반도체, 전자, 자동차의 산업 경쟁력을 바탕으로 차세대 통신, 인공지능, 산업 자동화 분야에서의 견고한 성장이 예상된다.

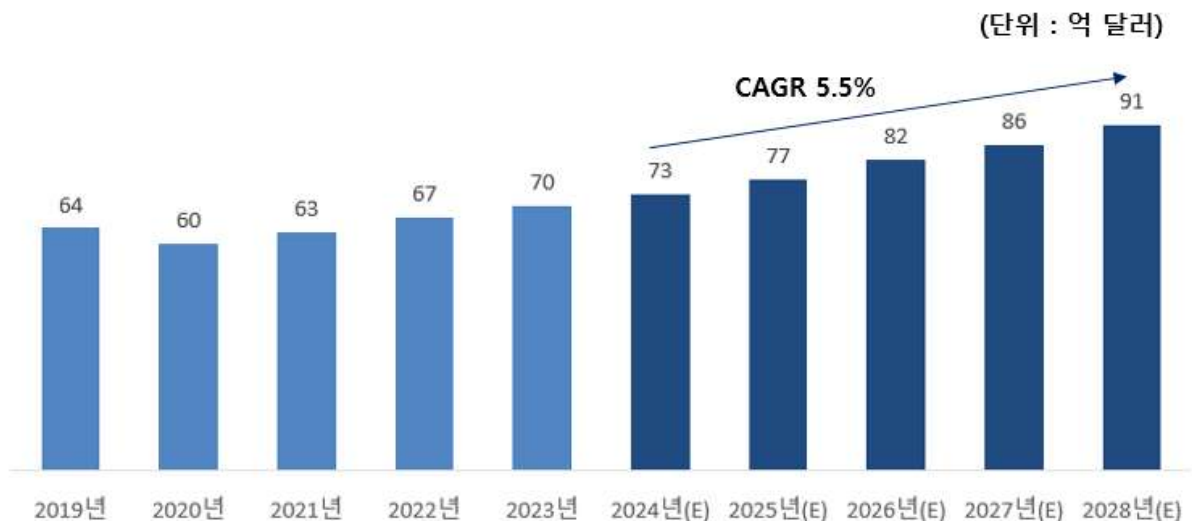
그림 4. 국내 전자파 차폐 재료 시장 규모 및 전망



출처: "EMI Shielding Market", MarketsandMarkets(2023, 2024), TDB기술시장보고서(2025), NICE평가정보(주) 재가공

한편, 세계 전자파 차폐 재료 시장규모는 2023년 기준 70억 달러이며, 이후 연평균 5.5% 증가하여 2028년 91억 달러에 이를 것으로 전망된다. 지역별 시장규모는 2023년 기준 아시아-태평양 지역이 29억 달러, 북미 지역이 20억 달러, 유럽 지역이 15억 달러 순으로 나타난다.

그림 5. 세계 전자파 차폐 재료 시장 규모 및 전망



출처: "EMI Shielding Market", MarketsandMarkets(2023, 2024), TDB기술시장보고서(2025), NICE평가정보(주) 재가공

스마트 디바이스용 EMI/EMC 소재 시장은 전체 EMI 차폐 시장의 핵심 세부 영역으로, 전체 EMI 차폐 수요 중 소비자 가전·모바일 기기(스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 등) 관련 비중은 약 33~40% 수준으로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 보고되며, 일부 리포트에서는 전자·모바일 기기 애플리케이션이 2024년 기준 약 40%의 점유율을 기록했다고 밝힌다. 이를 적용하면, 2024년 기준 스마트 디바이스용 EMI/EMC 소재 시장 규모는 대략 25억~30억 달러 수준으로 추산할 수 있으며, 이 중 전도성 테이프·필름·쿠션 등 디바이스 내부

다산솔루에타(154040)

부품용 소재가 상당 부분을 차지한다. 특히 EMI 차폐 테이프 시장만 별도로 보면 2023년 약 12억 달러에서 2032년 23억 달러로 성장할 것으로 전망되어, 연평균 약 7.6%의 높은 성장세가 예상된다. 향후 전망을 보면, 스마트폰 · 태블릿 · 노트북 · 웨어러블 기기의 고성능 · 고주파 · 고집적화와 5G · Wi-Fi 6/7 · UWB · Bluetooth 등 무선 인터페이스의 다중 탑재가 가속되면서, 기기 내부에서의 전자파 간섭(EMI) 리스크는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 고차폐 · 박형 · 유연 · 고신뢰성을 특징으로 하는 차세대 EMI/EMC 소재에 대한 수요가 확대되고, 특히 중국 · 한국 · 대만 · 일본 등 전자 · 반도체 생산 거점이 집중된 아시아 · 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것이라는 전망이 우세하다. 글로벌 관점에서 전체 EMI 차폐 시장은 2030년 전후까지 연평균 5% 안팎의 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상되며, 그 중 스마트 디바이스용 EMI/EMC 소재 시장은 소비자 가전 · 모바일 중심의 수요 확대와 폼팩터 변화(폴더블, 웨어러블, XR 기기 등)에 힘입어 이보다 다소 높은 성장률을 기록할 가능성이 높은 시장으로 평가된다.

주요 기관별 시장 전망

EMI 차폐 시장은 2025년에 약 78억 4천만 달러 규모를 넘어설 것으로 전망되며, 2035년에는 약 135억 2천만 달러 수준까지 확대될 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지의 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.6% 이상으로 예측되며, 또한 2026년 EMI 차폐 산업 규모는 약 82억 4천만 달러로 추정됩니다.

– Research Nester

전자기 차폐 시장 규모는 2024년에 약 35억 달러로 평가되며, 향후 CAGR 기준으로 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률은 약 8.2%로 예상되며, 이에 따라 2033년에는 시장 규모가 약 68억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

– Verified Market Reports

세계의 EMI 차폐 시장 규모는 2024년 73억 4,000만 달러에서 2029년까지 96억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간에 CAGR로 5.7%의 성장이 전망됩니다.

– Global Information

전 세계 EMI 차폐 시장은 2024년에 약 51억 9,140만 달러로 평가되었으며, 2033년까지 약 53억 4,715만 달러 수준으로 안정화될 것으로 예상됩니다. 또한 2025년에는 약 72억 1,670만 달러에 도달할 것으로 전망되며, 이는 2025년부터 2033년까지 약 3%의 연평균 성장률을 반영한 것입니다.

– Global Growth Insights

■ 경쟁업체 현황

전자파 차단 소재 산업은 스마트폰·노트북 등 IT 기기의 고도화와 더불어 무선통신 확산에 따라 꾸준히 성장하고 있으나, 제품 규격과 고객 요구 수준이 다양하여 기술력 기반의 경쟁이 심화되고 있다. 특히 제한된 공간에 고성능 회로가 집적되는 스마트 디바이스 특성상 고차폐·박형·고신뢰성 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 고객사 품질 요구 수준(전도율, 차폐율, 점착강도 등)을 충족할 수 있는 기업만이 공급망에 편입될 수 있어 제조원가보다 기술경쟁력이 시장경쟁의 핵심 요소로 작용한다. 이에 따라 소재의 도금·점착·코팅 기술을 내재화한 업체들이 우위를 확보하고 있으며, 글로벌 전자기기 제조사들은 안정적인 납품 능력과 품질 인증을 갖춘 소재 기업을 중심으로 공급망을 구축하고 있다.

국내 주요 경쟁 및 유사업체로는 전자파 차폐·흡수체와 도전성 점착 소재를 폭넓게 제조하는 이송이엠씨, 반도체 패키징용 EMI 차폐 페이스트를 개발하는 나노소재 기반 기업 엔트리움, IT·디스플레이용 기능성 테이프를 생산하는 대상에스티, 우주·의료·전장 분야로 적용 범위를 넓히고 있는 스페이스앤빈, 글로벌 고객사에 차폐·방열 솔루션을 공급하는 디아이머티리얼즈 등이 있다. 이들 기업은 소재 기술력과 응용 분야에 따라 차별화된 경쟁구도를 형성하고 있으며, 차세대 패키지·전장·우주 산업의 성장이 국내 차폐 소재 산업의 추가적인 확장을 견인할 것으로 예상된다. 해외에는 3M, Tesa, Nitto Denko, Laird 등 글로벌 EMC 소재 기업들이 있으며, 이들 업체는 스마트폰·태블릿·웨어러블 등 모바일 기기뿐 아니라 전장·IoT 기기까지 고객사를 확대하며 시장 내 경쟁 구도가 유지되고 있다.

표 3. 국내 주요 경쟁 및 유사업체 현황

회사명	주요 사업부문/제품	업체 현황
(주)이송이엠씨	전자파 차폐(EMI 차폐), 전자파 흡수, 열전도(방열소재) 분야	- 1990년대 설립, 서울 금천구 소재 전자부품 제조 중소기업 - 전자파 차폐·흡수·방열 소재에 특화되어 국내 EMI 업계를 선도
엔트리움(주)	전자재료 사업(전자파 차폐 및 방열 소재 개발 등), 바이오재료 사업	- 2013년 설립된 나노 소재 스타트업 - 반도체·모바일·전장용 EMI 차폐 및 방열 소재에 집중 - SK하이닉스 등과 협업해 세계 최초 패키징용 EMI 차폐 소재를 공급 이력 보유
대상에스티(주)	IT기기, 디스플레이, 반도체, 자동차 전장 소재 등에 사용되는 점착필름 및 테이프	- 2000년대 초 설립된 점·접착 소재 전문기업 - IT기기·디스플레이·반도체용 기능성 테이프 생산 - EMI 차폐 필름·테이프 및 방열 필름 관련 다수 특허와 국책과제 수행 중
(주)스페이스앤빈	전자파 및 방사선 차폐 솔루션 개발	- 2021년 설립된 방호 솔루션 스타트업 - 전자파·방사선 차단 복합소재를 기반으로 우주, 방산, 의료, 전기차 등으로 응용 분야를 확장 중
(주)디아이머티리얼즈	전자파 차폐 및 흡수 소재(EMI/EMC)와 2차전지 장비 및 ESS 컨테이너 사업	- 2006년 창립된 전자파·방열 솔루션 전문기업 - 국내외 전자제품·자동차 업체에 EMI·열 관리 제품을 공급

출처: 경쟁업체 홈페이지, NICE평가정보(주) 재가공

III. 기술 분석

전자파 차단·흡수 및 고방열 기능을 갖춘 전자소재 제조 기술 보유

동사는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 등 고집적 전자기기 내부에서 발생하는 전자파 간섭을 제어하기 위해 전도성테이프, 전도성쿠션, EMI 차폐시트 등의 차폐·흡수 소재를 자체 기술로 생산하고 있다. 니켈·구리 도금과 기능성 코팅을 기반으로 한 소재 성능 개선뿐 아니라 도금-점착-가공이 통합된 생산체계를 통해 다양한 규격의 고신뢰성 제품을 제공하고 있으며, 고방열 필름, 전파 흡수체 등 신소재 개발도 병행하여 차세대 전자기기 환경에 대응할 수 있는 제품군을 지속적으로 확장하고 있다.

■ 주요 사업 분야

동사는 전도성테이프와 전도성쿠션 등 EMI/EMC(전자파 차단·흡수) 소재를 중심으로 한 전자파차단소재 사업을 영위하고 있다. 전도성테이프는 구리·니켈 도금 및 기능성 코팅을 통해 전자파 간섭을 효과적으로 차단하도록 설계된 소재로, 스마트폰·노트북·웨어러블 등 고집적 전자기기 내부에서 회로 간 간섭을 억제하는 핵심 부품이다. 제품은 고객이 요구하는 전도율·차폐율·두께·점착강도 등 규격에 따라 세분화되며, 복잡한 구조에서도 안정적으로 부착될 수 있도록 초박형·고점착 특성을 갖춘 것이 특징이다.

전도성쿠션은 차폐 기능과 더불어 충격 흡수·완충 기능을 동시에 제공하는 소재로, 기기 외부 충격이나 진동에 취약한 부품을 보호하는 역할을 수행한다. 제한된 공간에 고성능 회로가 밀집되는 스마트 디바이스 특성상, 기구 강성 확보와 EMI 차폐를 동시에 충족해야 하므로 소재의 유연성, 내구성, 반발력 등이 중요한 요소로 작용한다.

동사는 도금-점착-가공까지의 일체형 수직계열화 생산체제를 통해 고객사 요구에 맞춘 규격 대응력을 확보하고 있으며, 이러한 제조 기술을 기반으로 스마트폰·태블릿·웨어러블은 물론 전장·IoT 기기 등 고성능 전자기기 시장에서 안정적인 공급 역량을 유지하고 있다.

표 4. 동사 주요 사업 분야 및 제품

구분	제품	주요 특징 및 기능
전자파차단소재 (EMI/EMC) 사업	전도성테이프	- 구리·니켈 도금 및 기능성 코팅을 적용한 차폐 소재 - 스마트폰·태블릿·노트북·웨어러블 등 고집적 기기 내부의 전자파 간섭(EMI) 차단 - 초박형·고전도율·고점착 특성으로 복잡한 내부 구조에 신속 대응 - 고객 요구(전도율·차폐율·두께·점착강도)에 맞춘 다양한 규격 제공
	전도성쿠션	- EMI 차폐 + 진동·충격 완화(흡수) 기능을 겸비한 복합 소재 - 스마트기기 내부의 취약 부품 보호 및 기구 안정성 확보 - 고탄성·내구성·유연성 기반으로 좁은 공간에서도 안정적 적용 - 제한된 공간에 고성능 회로가 밀집된 구조에서 필수 보호 소재
	기타 전도성 부자재	- 고객 맞춤형 규격의 전자파 흡수·차단 관련 보조 소재 제공 - 제품 특성상 규격 다양성에 따라 단가 편차 큰 시장 구조 - 스마트디바이스·전장·IoT 등 각종 전자기기용 소재 기반

출처: 동사 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

EMI/EMC 솔루션

동사는 스마트폰·태블릿·웨어러블·노트북 등 고집적 전자기기의 전자파 간섭(EMI) 및 정전기(ESD) 문제를 해결하기 위해 전도성 소재 기반의 테이프·쿠션·흡수체·가스켓 등 통합형 EMI/EMC 소재 솔루션을 제공하고 있다. 제품군별로 전도성 원단, 금속 도금, 기능성 점착제, 흡수체, 폼 소재 등을 조합하여 다양한 전자 기기에 최적화된 전자파 차폐 및 흡수 성능을 구현하며, 초박형·고점착·저저항 기술을 기반으로 글로벌 IT 제조사 요구 사양을 충족하는 고신뢰성 소재 기술을 확보하고 있다.

표 5. 동사의 EMI/EMC 솔루션 기술 개요 및 특징

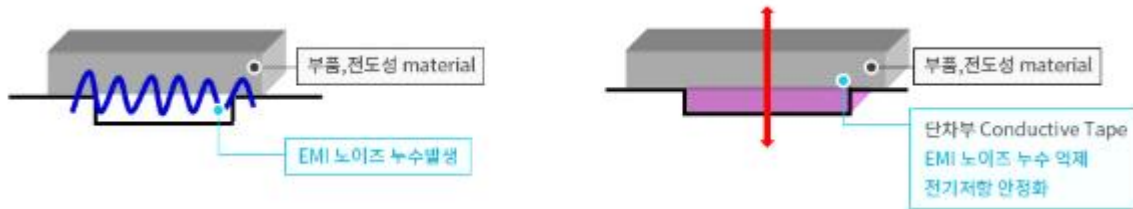
제품명	기술 개요	주요 기능	기술 특징
Conductive Fabric Tape (도전성 패브릭 테이프)	- 구리·니켈 등의 금속이 코팅된 도전성 원단과 전도성 점착제를 결합한 테이프 - 신호 간섭, 누설 전류, 접지(Grounding) 불량 등으로 인해 발생하는 EMI 문제를 해결	- 접지 경로 보상, EMI 노이즈 억제 - PCB-커넥터 접지 안정화 - 단자 보호 및 차폐 기능	- 표면저항 0.02~0.05Ω/sq 수준 - 두께 약 0.03mm의 초박형 구조 → 미세 공간에서도 적용 용이 - 높은 점착력(>600 gf/25mm)으로 기구물·금속부품과 안정적 결합
Conductive Black Tape (전도성 블랙 테이프)	- EMI 차폐와 함께 블랙 컬러 코팅을 통해 외관 일체감을 유지하는 테이프 - 디스플레이 주변부·커버샤시 간 EMI 차폐에 사용됨.	- 디스플레이 주변 EMI Noise 차단 - 표면 반사 방지 및 외관 개선 - Shielded metal cover의 EMI 억제	- 저저항(약 0.09~0.1Ω/sq) - 매우 높은 점착력(>800 gf/25mm) - 다양한 물리적 환경에서 Curl 현상 적고 작업성 우수
Conductive Cushion Tape (도전성 쿠션 테이프)	- 금속 프레임과 PCB 등 기구물 사이에 발생하는 EMI Noise와 ESD 문제를 흡수·차단하는 도전성 쿠션 소재 - 충격 방지와 접지 안정성을 동시에 확보	- 금속-PCB 간 접촉 불량/정전기 문제 해결 - 충격 흡수 및 접촉 안정성 확보 - FPCB 접지 패턴 보호	- 약 0.15mm의 유연한 두께 - 높은 점착력(>1,100 gf/25mm) - 표면저항 0.02~0.045Ω/sq 수준
Electromagnetic Wave Absorber (전자파 흡수체)	- 고주파에서 발생하는 EM 노이즈를 흡수·감쇠시키는 다층 구조의 흡수체(Absorber) - CPU·PMIC·RF Chip 등 고주파 부품에서 발생하는 EMI를 효과적으로 억제	- IC 칩 주변 EMI Noise 제거 - SUS Shield 대체흡수체로 경량화/공정 단순화 - 광대역(3MHz~GHz) 전자파 흡수	- Roll-to-Roll 생산으로 높은 비용 경쟁력 - Cu Tape + Absorber Sheet의 복합 구조 - Permeability(투과율) 80 수준의 고성능 자성체
EMI Gasket (EMI 가스켓)	- 도전성 패브릭·도전성 테이프·고탄성 폼(PU Foam)을 조합한 가스켓 - 외부 기구물과 PCB 사이 틈새에서 발생하는 EMI 누설 및 충격을 동시에 흡수	- 도전성 접촉을 통한 EMI 차단 - 충격 흡수·복원력 확보 - HUD, 블랙박스, 각종 전장·IoT 장치에 적용	- 다양한 형상 제작 가능 - 표면저항 0.1Ω/sq 이하 - 우수한 Compression Set(30% 이하)로 반복 사용에도 성능 유지

출처: 동사 홈페이지, NICE평가정보(주) 재가공

동사는 스마트폰·태블릿·웨어러블·노트북 등 고집적 전자기기의 전자파 간섭(EMI) 및 정전기(ESD) 문제를 해결하기 위해 전도성 소재 기반의 테이프·쿠션·흡수체·가스켓 등 통합형 EMI/EMC 소재 솔루션을 제

공하고 있다. 제품군별로 전도성 원단, 금속 도금, 기능성 점착제, 흡수체, 폼 소재 등을 조합하여 다양한 전자 기기에 최적화된 전자파 차폐 및 흡수 성능을 구현하며, 초박형·고점착·저저항 기술을 기반으로 글로벌 IT 제조사 요구 사양을 충족하는 고신뢰성 소재 기술을 확보하고 있다.

그림 6. Conductive Fabric Tape 기술



출처: 동사 홈페이지(2025)

Thermal 솔루션

Thermal 솔루션은 고집적·고성능 전자기기에서 발생하는 열을 효율적으로 분산·차단·흡수하여 기기 성능 저하와 EMI(전자파 간섭) 문제를 동시에 해결하기 위한 복합 소재 기반 열관리 기술이다. AP(Application Processor), DDI(Display Driver IC), PMIC, RF Chip, OLED 모듈 등 열 발생이 집중되는 부품 주변에 적용되어 기구물 변형 방지·온도 안정화·차폐 성능 유지를 지원한다.

표 6. 동사의 Thermal 솔루션 기술 개요 및 특징

제품명	기술 개요	주요 기능	기술 특징
Thermal Spread Tapes (열 확산 테이프)	- Cu Foil-Graphite Sheet-PI Film-Foam Layer 등 다층 구조로 설계된 고방열 복합 테이프 - AP Chip과 OLED 모듈에서 발생하는 열을 빠르게 분산 - EMI 차폐 테이프와의 복합 적용을 고려한 구조로 설계되어 열확산 + EMI 억제를 동시에 수행	- AP 및 DDI 주변 고온 영역의 열을 수평 방향으로 확산 - Graphite-Cu Foil 기반의 열전도 경로 확보 - OLED 발열 차단을 통해 화질·밝기 안정성 유지 - AP Chip에서 발생하는 EMI Noise를 동시에 차폐	- Protection Film → Cu Foil → Graphite Sheet → PSA/PI → Foam 등 다층 구조 - Foam Layer를 통해 자체적인 충격 흡수 기능도 제공 - Cu Spread Sheet와 Foam Tape의 복합 사용으로 다양한 두께 설계 가능 - 실제 적용 시 AP 주변의 온도를 유의미하게 낮추고, OLED 모듈의 열 전달을 차단함
GLPCB (Graphene-based LED PCB for Head Lamp)	- 자동차 전장용 LED 모듈의 발열 문제를 해결하기 위해 개발된 Graphene 도전층 기반 FPCB + AL GCL(Graphene Conduction Layer) 복합 방열 PCB 솔루션 - 전통적으로 사용되던 AL 1.0T 구조 대비 열전도 성능을 크게 향상시키면서도 경량·박형 설계를 가능하게 함	- 자동차 전/후방 헤드램프 LED 모듈의 발열을 신속히 방출 - 고밀도 LED 모듈에서도 과열로 인한 변색·수명 저하 방지 - 기존 구조 대비 두께 감소 + 열전도 향상으로 기구 설계 자유도 증가 - 곡면·다양한 형상에도 적용 가능한 유연성 확보	- Graphene 분산 기술 및 Binder-Coating 기술 기반 - 점착층과 PI Film을 포함한 다층 FPCB 구조 위에 GCL과 AL을 추가한 복합구조 - X-Y축 방향 열전도율 200 W/mK 이상 - Total Thickness 약 0.05 mm ± 0.01mm의 초박형 구조

출처: 동사 홈페이지, NICE평가정보(주) 재가공

다산솔루에타(154040)

동사의 Thermal 솔루션은 금속 포일, 흑연(그래파이트), PI 필름, 도전성 층, 폼 등 다양한 기능성 소재의 조합을 통해 열 확산·열 차단·열 안정성·EMI 억제가 동시에 가능한 하이브리드형 방열 기술을 제공한다. 특히 AP·DDI 등 모바일 디바이스의 고온 부위와 자동차 전장 LED의 고연속 발열 환경에서 우수한 신뢰성을 보여, 차세대 스마트폰·웨어러블·전장 분야의 필수 소재로 활용되고 있다.

그림 7. Thermal Spread Tapes 기술



출처: 동사 홈페이지(2025)

■ 연구개발 활동

동사는 전자파차단소재 부문을 중심으로 기업부설연구소를 운영하며, 전도성테이프·전도성쿠션 등 EMI 차폐 소재의 성능 고도화와 신소재 기술 개발에 주력하고 있다. 연구조직은 소재 설계부터 도금·점착·가공 공정까지 전 과정의 기술 확보를 목표로 하고 있으며, 최근에는 고방열 시트, 그래핀 기반 기능성 소재, 금속 나노파우더 등 차세대 전자소재 분야로 연구 범위를 확장하고 있다.

동사는 전자파 차폐 시트, 가스켓, 방열시트, 그래핀 분산액, 전도성 부직포 등 다양한 소재 기술 관련 특허를 지속적으로 확보해 왔으며, 최근에는 디지털타이저용 EMI 차폐 시트, 청색광 차단 필름, 디스플레이용 기능성 필름 등 신규 특허 출원도 이어지고 있다. 2025년 3분기 기준 연구개발비는 전자파차단소재 부문에서 1,312,970천 원 수준이며, 매출 대비 5.2%를 연구개발에 투입하는 등 전자소재 경쟁력 강화를 위한 지속적인 연구개발 활동을 수행하고 있는 것으로 확인된다.

표 7. 동사의 연구개발 비용 투입 현황

(단위 : 천 원, %)

사업분류	구분	2023년	2024년	2025년 3분기 누적
전자파차단 소재 부문	연구개발비	2,714,154	2,101,401	1,312,970
	매출액 대비 연구개발비 비중	8.7%	6.0%	5.2%

출처: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)(2025.11.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 기술 진입장벽

동사는 전도성테이프, 전도성쿠션, EMI 차폐시트 등 전자파 차단 소재 기술과 관련하여 국내·해외 특허를 다수 확보하고 있으며, 니켈·구리 도금, 기능성 코팅, 고방열 필름 등 신소재 기반 기술을 꾸준히 축적하며 기술 보호에 힘쓰고 있다. 또한 도금-점착-가공을 단일 라인으로 수행하는 일체형 수직계열화 공정을 보유하고 있어 동일 수준의 품질·납기 경쟁력을 확보하기 위해서는 상당한 설비 투자와 공정 경험이 요구된다.

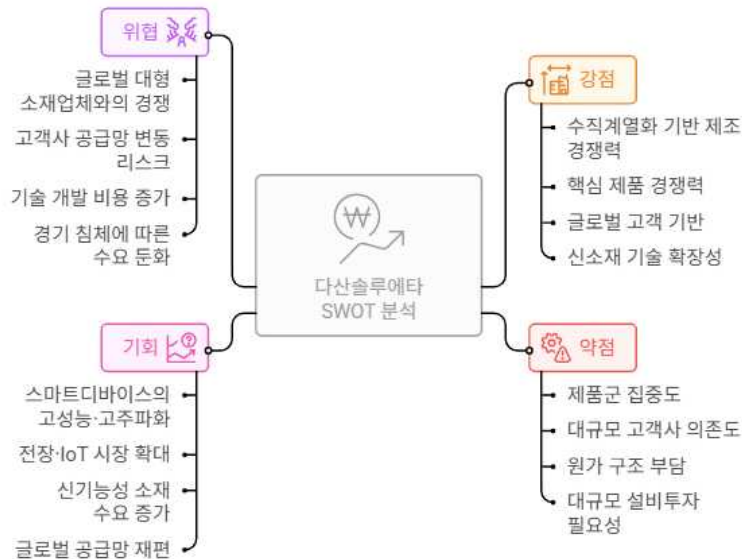
스마트폰·태블릿·웨어러블 등 글로벌 IT 제조사의 소재 채택(Spec-in)은 엄격한 신뢰성 시험, 규격 검증, 대량생산 품질 매칭 과정을 수반하기 때문에, 신규 업체가 고객사 공급망에 진입하기는 쉽지 않다. 특히 제품의 두께, 점착력, 전도율 등 세부 규격이 고객사별로 상이해 다년간의 공정 최적화 경험이 필요하며, 이는 자연스

다산솔루에타(154040)

럽게 경험 기반의 기술 장벽으로 작용한다.

동사는 이러한 기술·공정·품질 경쟁력을 기반으로 글로벌 제조사의 요구 성능에 부합하는 소재를 안정적으로 공급해 왔으며, 다년간의 납품 이력과 공정 노하우가 신규 경쟁자의 진입을 어렵게 만드는 핵심 장벽으로 작용하고 있다.

SWOT 분석



1. 강점 (Strengths)

- 수직계열화 기반 제조 경쟁력: 도금-점착-가공을 아우르는 원스톱 생산체계를 보유하고 있어 고객사 요구 규격(두께 · 점착력 · 전도율)에 대한 대응력과 납기 준수 능력이 높음.
- 핵심 제품 경쟁력: 전도성테이프 · 전도성쿠션 등 스마트 디바이스용 EMI/EMC 소재 중심의 제품 포트폴리오를 확보하고 있으며, 고신뢰성 소재 요구가 증가하는 글로벌 제조사 벤더 체계에서 안정적 공급 경험을 축적함.
- 글로벌 고객 기반: 스마트폰 · IT 디바이스 제조사향 수출 비중이 높아, 글로벌 시장에서 제품 신뢰성과 양산 품질에 대한 검증은 이미 확보하고 있음.
- 신소재 기술 확장성: 고방열 필름, 금속 나노파우더, 전파흡수체 등으로 연구개발 영역을 확장하고 있어 차세대 고집적 · 고주파 기기에 요구되는 소재 기술 확보 가능성이 높음.

2. 약점 (Weaknesses)

- 제품군 집중도: 매출이 전도성테이프 · 전도성쿠션에 편중되어 있으며, 상대적으로 신규 응용분야(전장 · IoT 등)에서 매출 기반이 아직 제한적임.
- 대규모 고객사 의존도: 글로벌 스마트디바이스 제조사의 수요 변동에 직접적으로 노출되어 경기 · 출시사이클의 영향을 크게 받음.
- 원가 구조 부담: 금속 도금 및 기능성 코팅 등 소재 · 공정 단가 비중이 높아, 원재료 가격 변동이 수익성에 미치는 영향이 큼.
- 대규모 설비투자 필요성: 공정 일체화 특성상 신규 공정 확장에 비용이 크며, 장기적으로 생산시설 유지 및 개조에 대한 부담이 존재함.

3. 기회 (Opportunities)

- 스마트디바이스의 고성능 · 고주파화: 5G · Wi-Fi 6/7 · 멀티 안테나 · 고집적 회로 증가로 EMI/EMC 소재 수요가 중장기적으로 확대될 전망임.

- 전장·IoT 시장 확대: 차량 전장화, 무선충전기, IoT 센서 등 무선 기능이 고도화된 응용 제품 증가로 차폐·흡수 소재 적용 분야가 지속 확대됨.
- 신기능성 소재 수요 증가: 고방열, 초박형, 유연기판 등 차세대 전자소재의 성장으로 동사의 연구개발 영역과 제품 확장 가능성이 큼.
- 글로벌 공급망 재편: 고품질 소재의 안정적인 공급이 중요해지면서, 기존 벤더 인증을 확보한 업체의 진입 장벽·단가 경쟁력이 유리하게 작용할 가능성이 존재함.

4. 위협 (Threats)

- 글로벌 대형 소재업체와의 경쟁: 3M, Nitto Denko, Tesa, Laird 등 글로벌 EMC 소재 기업과 경쟁해야 하며, 규모의 경제와 브랜드 신뢰도 측면에서 열위함.
- 고객사 공급망 변동 리스크: 대형 IT 제조사의 공급망 조정, 단가 인하 요구, 벤더 변경 등으로 매출 변동성이 발생할 수 있음.
- 기술 개발 비용 증가: 스마트 디바이스의 고주파·고집적화에 따라 차폐·흡수·방열 소재 개발 난이도가 높아지고 R&D 비용 부담이 확대됨.
- 경기 침체에 따른 수요 둔화: 스마트폰·IT 디바이스 판매량 감소 시 제품 수요가 동반 하락하는 구조로, 전방 경기 변동의 영향을 크게 받을 가능성이 존재함.

IV. 재무분석

2025년 3분기 매출 감소에도 수익성 개선

2024년 동사는 (주)디엠씨 종속기업 연결 제외로 매출액이 전년 대비 감소하고, 지분법손실로 인해 당기 순이익이 적자를 나타내었으나, 2025년 3분기에는 매출 소폭 하락에도 금융수지 및 기타수지 개선으로 순이익률이 84.6%를 기록하며 수익성이 개선되었다.

■ 종속기업 연결 제외로 2024년 매출액 감소

동사는 전도성테이프, 전도성쿠션, 전파흡수체 등의 제품을 판매하는 전자파차단소재 부문을 영위하며, 2024년 결산 기준 전도성테이프 제품이 전체 매출의 46.0%, 전도성 쿠션 제품이 48.7%를 차지하고 있다. 동사의 최근 매출 실적을 살펴보면, 2022년 1,579억 원의 매출을 시현한 이후 2023년에는 연결 자회사의 실적 개선으로 매출액이 전년 대비 0.6% 증가하였다. 2024년에는 (주)디엠씨에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결 제외되며 자동차부품 부문이 중단영업으로 분류되었고, 매출액이 전년 대비 77.7% 감소하였다. 2025년 3분기 누적 매출은 252억 원으로, 주요 고객 수주 감소로 인해 전년 동기 대비 14.9% 하락하였다.

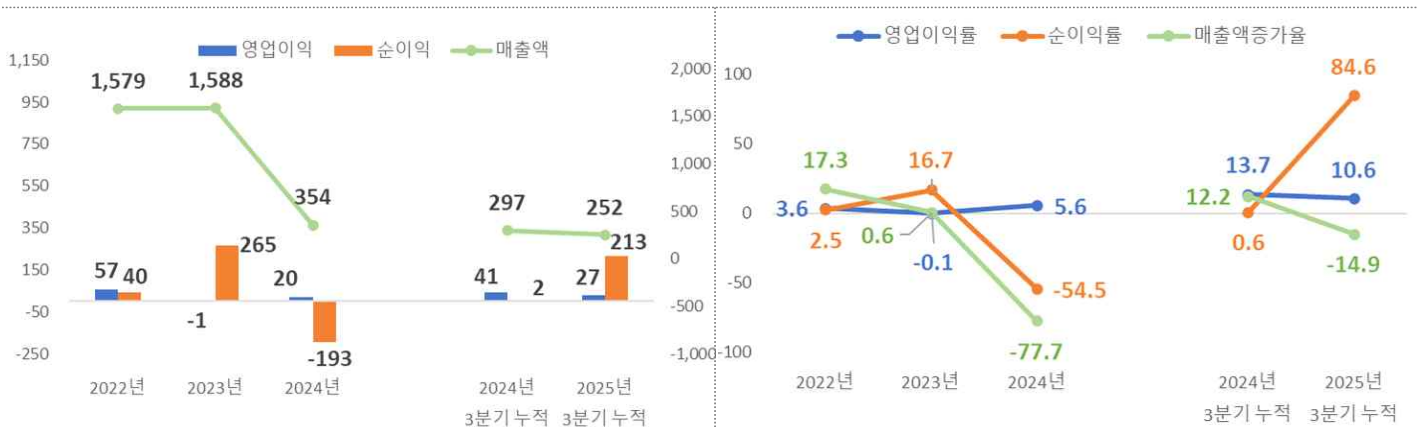
■ 2025년 3분기 당기순이익 규모 확대

2023년 동사는 매출이 전년 대비 9억 원 증가하였음에도 원가 상승 및 연구개발비 등 고정비 확대로 영업이익이 전년 대비 58억 원 감소하였다. 지분법이익이 약 301억 원 인식되며 당기순이익은 225억 원 확대되고, 순이익률이 16.7%로 상승하였다.

2024년에는 매출액이 2023년 연결 기준 매출액 1,588억 원 대비 큰 폭으로 하락하였으나, 2023년 개별 기준 매출액 314억 원 대비 40억 원 증가하였다. 원가 하락 및 지급수수료 등 판관비가 감소하며 영업이익은 21억 원 증가하고, 5.6%의 영업이익률을 기록하였다. 지분법손실이 약 165억 원, 법인세비용이 약 17억 원 발생하며 당기순이익은 193억 원의 적자를 나타내었다. 2025년 3분기에는 매출이 전년 대비 하락함에 따라 영업이익이 14억 원 축소되었으나, 파생상품평가이익 등 금융수익, 관계기업투자주식처분이익으로 인한 기타수익 증가로 당기순이익이 211억 원 확대되며 84.6%의 순이익률을 기록, 수익성이 크게 향상되었다.

그림 8. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, K-IFRS 연결, 2024년 이후 개별 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

다산솔루에타(154040)

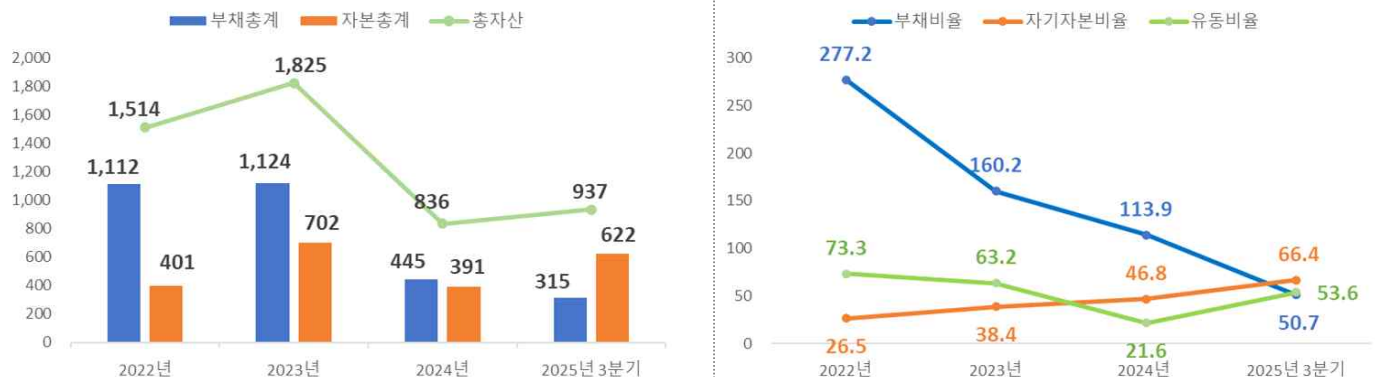
■ 재무건전성 개선의 흐름

2023년 동사는 관계기업및공동기업투자자산, 이연법인세자산 등 유동자산의 확대로 총자산이 311억 원, 비유동부채의 감소에도 유동성전환사채가 급증하며 부채총계는 12억 원 증가하였다. 유동부채의 증가율이 유동자산의 증가율을 상회하며 유동비율은 10.1%p 하락하고, 전환사채의 주식전환으로 자본총계가 301억 원 확대되며 부채비율이 117.0%p 하락, 자기자본비율이 11.9%p 상승하였다.

2024년에는 종속기업 연결 제외로 총자산이 836억 원, 부채총계가 445억 원, 자본총계가 391억 원을 기록하였다. 이에 따라 부채비율은 46.3%p 하락, 자기자본비율은 8.4%p 상승하고 유동자산의 감소로 유동비율이 41.6%p 하락하였다. 2025년 3분기에는 당기순이익 확대로 현금흐름이 개선되며 총자산이 101억 원 증가하고, 유동성전환사채, 유동금융부채가 감소하며 부채총계는 130억 원 축소되었다. 이에 따라 유동비율이 32.0%p 상승, 부채비율이 63.2%p 하락하고, 이익잉여금 누적으로 자본총계가 231억 원 증가하며 자기자본비율은 19.6%p 상승하였다. 동사는 단기지급능력은 다소 우려되나, 부채비율이 하락, 자기자본비율이 지속 상승하며 재무 구조가 개선되는 흐름을 보이고 있다.

그림 9. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, K-IFRS 연결, 2024년 이후 개별 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

표 8. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결, 2024년 이후 개별 기준)

항목	2022년	2023년	2024년	2024년 3분기 누적	2025년 3분기 누적
매출액	1,579	1,588	354	297	252
매출액증가율(%)	17.3	0.6	-77.7	12.2	-14.9
영업이익	57	-1	20	41	27
영업이익률(%)	3.6	-0.1	5.6	13.7	10.6
순이익	40	265	-193	2	213
순이익률(%)	2.5	16.7	-54.5	0.6	84.6
부채총계	1,112	1,124	445	525	315
자본총계	401	702	391	595	622
총자산	1,514	1,825	836	1,120	937
유동비율(%)	73.3	63.2	21.6	40.1	53.6
부채비율(%)	277.2	160.2	113.9	88.1	50.7
자기자본비율(%)	26.5	38.4	46.8	53.2	66.4
영업현금흐름	167	-10	15	9	82
투자현금흐름	-55	-102	188	146	90
재무현금흐름	-74	49	-208	-153	-123
기말 현금	129	65	15	21	64

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

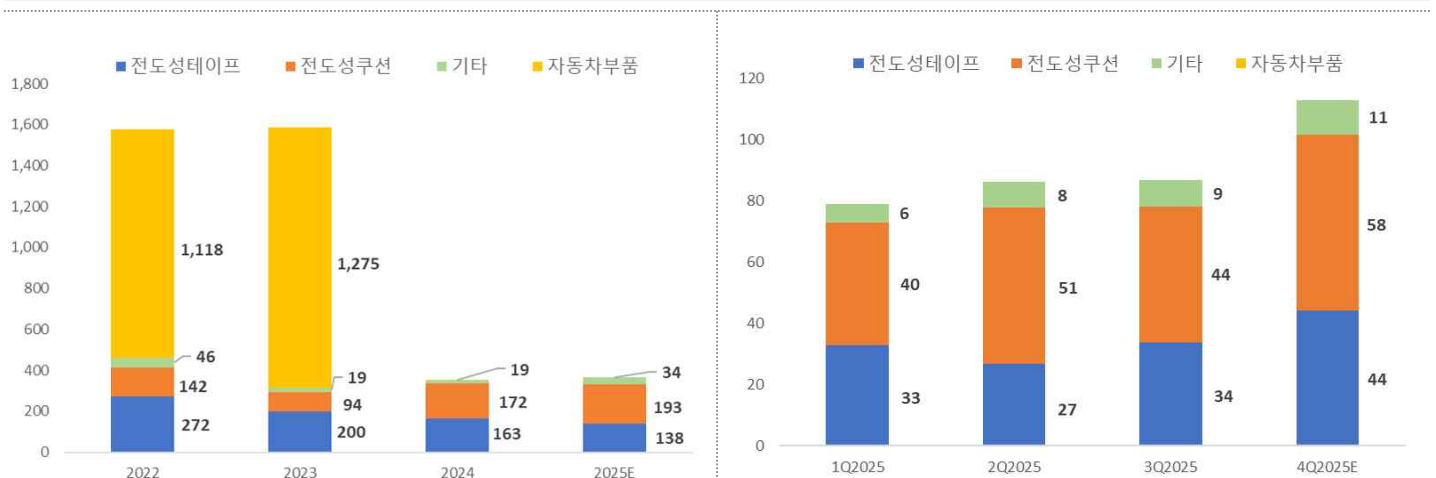
■ 동사 실적 전망

동사는 전자과차단소재 단일 사업부문을 중심으로 운영하는 기업으로, IT·모바일·자동차 전장화 확대에 따라 전자과 차폐 수요가 지속 증가하는 시장에서 기술력과 생산능력을 기반으로 경쟁우위를 유지하고 있다. 종속기업이었던 (주)디엠씨에 대한 지배력을 상실함에 따라 자동차부품 사업은 중단영업으로 분류되었으며, 현재는 전자과차단소재 분야에 집중함으로써 사업 구조를 효율적으로 재편한 상태이다.

동사는 업계 최초로 도금·점착 공정을 모두 자체 구축한 수직계열화를 달성하여 소재 개발부터 완제품 생산까지 전 과정 대응이 가능한 체제를 갖추고 있으며, 글로벌 IT 기업들의 까다로운 품질·납기 요구에 신속하게 대응하는 역량을 확보하고 있다. 또한 스마트기기·IoT·전기차 등 고성능·고집적 전자기기의 확산에 따라 전자과 차단 소재의 적용 범위가 확대되고 있어 향후 성장 잠재력이 높다. 2024년에는 글로벌 경기 둔화에도 불구하고 원가 절감과 환율 효과로 실적이 개선되었으며, 2025년에도 기술 경쟁력 강화와 사업영역 확장을 통해 불확실한 시장환경 속에서도 성장을 이어갈 전략이다.

그림 10. 동사 사업부문별 실적 및 전망

(단위: 억 원, K-IFRS 연결, 2024년 이후 개별 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

표 9. 동사의 사업부문별 연간 실적 및 분기별 전망

(단위: 억 원, K-IFRS 연결, 2024년 이후 개별 기준)

항목	2022	2023	2024	2025E	1Q2025	2Q2025	3Q2025	4Q2025E
매출액	1,579	1,588	354	365	79	86	87	113
전도성테이프	272	200	163	138	33	27	34	44
전도성쿠션	142	94	172	193	40	51	44	58
기타	46	19	19	34	6	8	9	11
자동차부품	1,118	1,275	0	0	0	0	0	0

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 분기보고서(2025.09.), NICE평가정보(주) 재가공

V. 주요 변동 사항 및 향후 전망

재무구조 개선과 소재 중심 사업전환을 통한 성장 기반 강화

동사는 전환사채 조기상환과 종속회사 지분 매각을 통해 재무건전성을 높이고 사업구조를 정비하였으며, 최근 증가하는 글로벌 IT 공급망 수요에 대응하기 위해 EMI/EMC 차폐소재 및 기능성 필름 중심의 소재 사업으로 포트폴리오를 전환하고 있다. 이러한 구조조정과 사업 집중 전략을 기반으로 향후 스마트디바이스·웨어러블·IoT 시장에서 안정적 성장이 가능할 것으로 전망된다.

■ 재무구조 개선을 위한 전환사채 조기상환 및 종속회사 지분 매각

동사는 2024년 10월 제 6회차 전환사채 잔액 약 43.74억 원 전액 조기상환을 완료하였으며, 같은 해 4월에는 자회사인 (주)디엠씨의 지분율을 67.0%에서 15.4%로 대폭 낮추는 지분 매각을 시행하였다. 또한 2023년에는 베트남 소재 법인 SOLUETA VINA CO., LTD 지분을 처분하고 필터사업을 중단하는 등 사업구조 정리를 병행하였다. 이 같은 구조조정으로 부채 부담이 경감되고 선택과 집중이 가능해졌으며, 향후에는 소재 사업 중심으로 재무건전성과 수익성 확보 기반이 강화될 가능성이 높다.

■ 글로벌 IT 공급망 대응을 위한 소재 중심 사업 포트폴리오 전환

동사는 글로벌 스마트디바이스 제조사의 요구 급증에 대응하여 기존 부품 중심 사업에서 EMI/EMC 차폐소재 및 기능성 필름 중심의 고부가가치 소재 사업으로 사업영역을 전환하고 있다. 또한 수출 비중이 높아지고 있다는 보도가 나오면서 글로벌 공급망 진입 가능성이 부각되었다. 향후에는 스마트폰·웨어러블·IoT 시장의 고주파·고집적화 흐름을 바탕으로 소재사업 확장이 가시화될 것이며, 이는 안정적 매출 창출과 기술경쟁력 확보 측면에서 핵심 성장동력이 될 것이다.

최근 뉴스와 향후 전망

☑ 프롬프트: 동사의 최근 뉴스와 향후 전망에 대해 알려주세요.

☑ 생성형 AI 답변:

(주)다산솔루에타의 최근 뉴스에 따르면, 회사는 사업 구조 재편으로 본업인 전자부품 사업에 집중하고 있습니다. 그동안 활발하게 진행하던 인수합병(M&A) 및 자회사 투자에서 벗어나, 현금 유동성 확보와 사업 구조 단순화 전략을 펼치고 있습니다. 자회사 지분 매각을 통해 재무 안정화에 신경 쓰는 한편, 앞으로는 M&A는 자회사(다산네트웍스) 중심으로만 추진할 계획입니다.

다산솔루에타는 앞으로 신규 지분 투자를 중단하고, 전자부품 본업 경쟁력 강화에 집중할 방침입니다. 코스닥 상장 유지 요건, 즉 일정 시가총액을 유지해야 하는 부담이 있지만, 이제는 본업 외형 성장과 수익성만으로 평가받는 구조로 전환했습니다. 핵심 소재인 전자파차단소재, 무선충전기, NFC 등 시장 확장에 따라 새로운 고객사 확보 노력을 병행할 가능성이 높습니다. 중국산 저가 제품과의 경쟁이 심화되고 있기 때문에 수익성 개선을 위한 새로운 돌파구가 필요해 보입니다. 요약하면, 다산솔루에타는 본업 강화 및 내실 경영에 집중하는 구조 개편을 진행 중이며, 향후 시장 확대와 고객 다변화가 중요한 관건이 될 전망입니다.

출처: Perplexity

다산솔루에타(154040)

증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
-	-	-	-
최근 6개월 내 발간보고서 없음			

시장정보(주가 및 거래량)

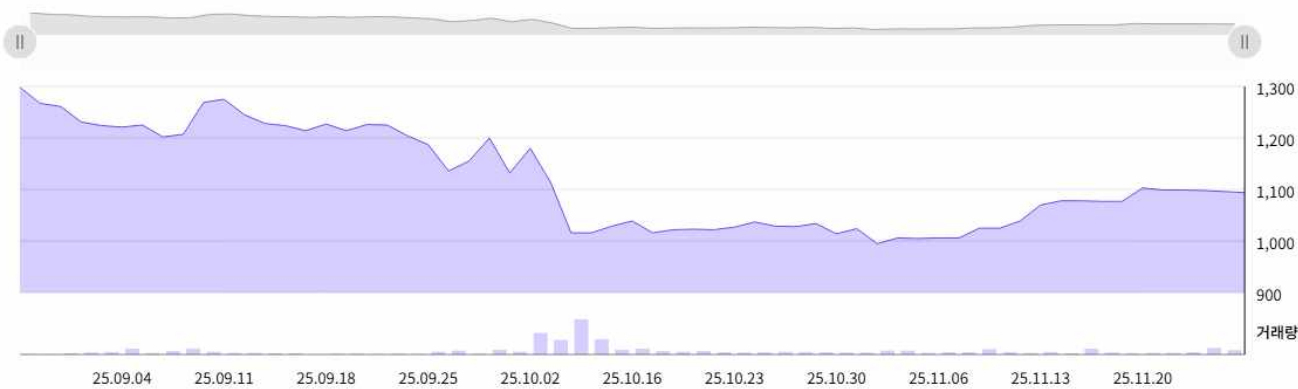
154040 코스닥

기준 : 2025.11.27 | 단위 : 원, 주, %

1,094 ▼2 -0.18%

전일 1,096 고가 1,096 거래량 45,460 주
시가 1,096 저가 1,075 거래대금 49 백만원

1주일 3개월 6개월 1년 3년 5년



자료: NICE BizLINE(2025.11.27)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?
한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자 주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.
시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
(주)다산솔루에타	O	X	X

2025년 10월 2일 종가급변으로 투자주의종목으로 지정된 바 있음.